

证券代码： 002979

证券简称：雷赛智能

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-04

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	东吴证券、国信证券、汇添富基金、普信基金、诚通基金、明亚基金、创金合信基金、安信基金、善思投资、金信基金。
时间	2026年5月14日 下午15:00-17:00
地点	深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：李卫平先生 董事会秘书：向少华先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、投资者会议问答交流</p> <p>Q1:公司的经营目标？目前经营形势情况？</p> <p>A:公司2026年度业绩目标为同比增长30%-50%。公司将继续以客户需求为战略原点，坚守“以客户为中心”的核心价值观，深化“三线协同”作战体系，全面推动“大赛道大增长”的“大行业+大爆品+大网络+大协同”四大型增长战略落地。上述业绩目标不代表公司对2026年度的业绩预测，能否实现受宏观经济形势、下游市场需求变化等因素影响，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。</p> <p>当前公司订单交付形势良好、预计Q2有望延续Q1加速增长趋势。</p>

Q2:有别于其他友商的涨价策略，现阶段公司定价策略情况？

A:面对行业竞争加剧以及物料涨价等不利因素，公司上半年大部分产品不涨价还保持稳定略增的毛利率水平，主要得益于公司制定实施了提效降本“两提两降”经营策略，内外部挖潜，盈利能力稳中有升，将物料危机转化为公司加速增长的契机。

下半年公司将继续推进提效降本的“两提两降”经营策略，并密切关注原材料的价格态势，结合内部盈利水平适时决定价格策略。

Q3:请问公司人形机器人产品结构及收入利润情况？该业务板块未来布局规划？

A:公司机器人业务定位是核心零部件、组件和解决方案提供商，为众多整机厂家提供系列化伺服控制核心部件和模组级解决方案。公司已成功研发并批量供应高密度无框力矩电机、中空编码器、空心杯电机及配套的微型伺服系统、行星关节模组、谐波关节模组以及21自由度灵巧手等核心产品。

2025年，公司的无框力矩电机产品交付超过12万台，取得20倍以上的增长，目前订单与交付处于良好高增形势；公司的行星关节模组、谐波关节模组以及21自由度灵巧手研发成功并实现批量供应，目前已经获得数十家主流机器人客户订单，并开始规模化供货。根据国内外客户业务预期，目前正在建设年产200万台的自动化生产制造能力，2026年业绩有望持续加速增长。

未来公司将持续加大机器人业务的投入，力争成为国内外市场的头部供应商。

Q4:如何看待当前工控自动化行业的周期位置？

A:结合行业数据及一线订单情况，工控自动化整体处于周期底部筑底尾声（订单需求边际改善）、温和复苏初期（OEM市场回暖）、结构性分化明显（半导体等下游行业国产替代加速），随着十五五规划政策落地、AI融合及产业链升级、中美关系缓和及消费信心回升等因素驱动，行业有望加快进入新一轮的强景气上行通道。

	<p>Q5:公司如何看待AI投资的机会点，有何布局？</p> <p>A:AI产业投资正从算力基建、人形机器人、工业智造、全球产能转移四个维度，为工控行业带来结构性高景气与长期成长空间。</p> <p>人形机器人方面的布局：公司已经成功研发高密度无框力矩电机、空心杯电机、行星关节模组、谐波关节模组以及高自由度灵巧手等产品并取得较大市场突破，公司的机器人核心部件产品已进入国内80%主流人形机器人厂商的供应体系，不断获得头部客户的认可及订单，有望成长为公司第二增长曲线。</p> <p>公司在 PCB/PCBA、光模块、半导体封测等自动化设备领域，提供实时核+抑振算法+定制化轨迹算法等功能，打造“硬件定制+算法内嵌+工艺赋能”的“控制+伺服+五相步进”整体解决方案，在精度、效率及稳定性方面给客户不断带来价值提升。</p> <p>Q6:公司如何拓展半导体设备行业的客户？</p> <p>A:近年来，公司坚持大行业大客户战略，半导体设备行业是重点布局的战略新兴行业之一，公司在半导体设备行业围绕大客户核心需求打造爆品与场景方案，主推的EtherCAT总线，以其开放性优势在客户侧深受好评，同时叠加公司在耦合/贴片/AOI分选等设备的工艺提炼，提供实时核+抑振算法+定制化轨迹算法等功能，打造“硬件定制+算法内嵌+工艺赋能”的“控制+伺服+五相步进”整体解决方案，在精度、效率及稳定性方面给客户不断带来价值提升，助力公司产品在半导体设备行业的市场份额持续快速提升。</p> <p>接待过程中，与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。前述业绩预期不构成业绩承诺，没有出现未公开重大信息泄露等情况，投资者自己注意控制风险。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年5月14日